**News Release**

No.: REN2226(A)

**Renesas Lancia il SoC con Connettività Bluetooth Low Energy più Integrato ed Innovativo al Mondo**

*La nuova famiglia di SmartBond DA1470x offre dimensioni estremamente ridotte per applicazioni integrate, ed include processori grafici 2D, rilevatore di attività vocale e unità di gestione dell’alimentazione; queste caratteristiche e funzionalità rende questi dispositivi perfetti per realizzare prodotti IoT di piccole dimensioni*

**Düsseldorf, 21 Giugno 2022 –** Renesas Electronics Corporation (TSE:6723) oggi annuncia la famiglia SmartBond™ DA1470x per soluzioni Bluetooth® Low Energy (LE) – i SoC (System-on-Chip) più avanzati ed integrati al mondo, per la connettività wireless.

La famiglia DA1470x è l’unica serie di dispositivi [Bluetooth LE](https://www.renesas.com/products/interface-connectivity/wireless-communications/bluetooth-low-energy?utm_campaign=conn_ble_da1470x&utm_source=press_release&utm_medium=press_release&utm_content=ble) sul mercato che integra un’unità per la gestione dell’alimentazione, un hardware dedicato al riconoscimento di attività vocale (VAD), un’unità di elaborazione grafica (GPU) e la connettività Bluetooth® LE, tutto all’interno di un unico chip. La combinazione di questi elementi offre la possibilità di progettare prodotti IoT intelligenti, con le più avanzate funzionalità grafiche e di sensoristica, elaborazione audio sempre attiva, ed un bassissimo consumo. La nuova famiglia è ideale per i dispositivi indossabili come smartwatch e fitness trackers, dispositivi per lettura e monitoraggio del glucosio, dispositivi medici e sanitari di consumo, elettrodomestici con display, sistemi per automazione industriale e sicurezza, console Bluetooth per e-bike e attrezzatura per videogiochi.

“La famiglia DA1470x è basata sulla nostra strategia vincente di integrare molte funzioni, fornire una maggiore potenza di elaborazione, integrare più memoria e ottimizzare i moduli d’alimentazione, aggiungendo anche la funzionalità VAD, per il risveglio del dispositivo mediante il riconoscimento di un comando”, afferma **Sean McGrath, Vice Presidente del dipartimento Connectivity and Audio, nella Business Unit IoT, Industrial and Infrastructure di Renesas**. “Questa famiglia di SoC ad alta integrazione consente agli sviluppatori di innovare i prodotti connessi, sia in campo industriale, sia di consumo, e rendere i loro prodotti IoT a prova di futuro, per soddisfare l’esigenza di diverse applicazioni, ottimizzando allo stesso tempo la loro distinta base.”

L’alto livello d’integrazione si traduce inoltre in un notevole risparmio in termini di costo per la distinta base (BoM), permettendo di realizzare soluzioni convenienti a livello di sistema. Il numero di componenti sulla scheda è minore, ciò consente di produrre un prodotto di dimensioni contenute, lasciando spazio libero per l’aggiunta di componenti addizionali o batterie di maggiori dimensioni. La riduzione del numero di componenti presenti sulla scheda incrementa l’affidabilità del sistema e di conseguenza abbatte il costo totale del prodotto finito (COGS).

La famiglia SmartBond DA1470x sta già prendendo piede sul mercato. Per esempio, **il DA14706 è il cuore del nuovo bracciale Xiaomi Mi Band 7**, il quale dispone di un accattivante display AMOLED di dimensioni 192x490 1.62”, offre 120 modalità di sport e una durata della batteria di 15 giorni per l’utilizzo tipico.

**Caratteristiche principali dei SoC Wireless DA1470x**

* Sistema multi core – un processore Arm® Cortex®-M33 come core per l’applicazione principale ed un Cortex-M0+ per la gestione centralizzata dei sensori.
* GPU 2D integrata e controller per display con supporto per DPI, JDI parallelo, DBI e interfacce Single/Dual/Quad SPI.
* MAC configurabile con supporto per Bluetooth® LE 5.2 e protocolli proprietari a 2.4 GHz.
* Caricatore USB integrato conforme JEITA da 720 mA per ricaricare batterie Li-ion/Li-Po.
* PMU integra un convertitore DC/DC SIMO, a bassa corrente di quiescenza, il quale alimenta in modo efficiente sia il sistema interno, sia i componenti esterni.
* Funzionalità hardware VAD, a bassissimo consumo, consente un’elaborazione dell’audio continua e sempre attiva.

**Winning Combination**

Renesas ha preparato due nuove Winning Combination che includono il nuovo DA1470x e diversi componenti dal suo vasto catalogo, tra cui processori, parti analogiche, di alimentazione e connettività: un [Dispositivo indossabile per il tracciamento di attività](https://www.renesas.com/application/consumer-electronics/wearables-non-medical/wearable-activity-tracker?utm_campaign=conn_ble_da1470x&utm_source=press_release&utm_medium=press_release&utm_content=activity_tracker) e il [Cruscotto per veicoli elettrici leggeri](https://www.renesas.com/application/automotive/connected-infotainment/instrument-panel-light-electric-vehicles?utm_campaign=conn_ble_da1470x&utm_source=press_release&utm_medium=press_release&utm_content=lev_ebike).

Renesas offre più di 300 Winning Combinations create aggregando dispositivi complementari del proprio catalogo, per consentire ai clienti di accelerare il processo di progettazione e arrivare sul mercato più rapidamente. Le Winning Combination si trovano alla seguente pagina: [renesas.com/win](file:///C:\Users\krkelly\Documents\Dialog%20PLs\Connectivity\BLE\DA1470x\renesas.com\win)

**Demo all’evento Embedded World**

La famiglia DA1470x sarà presentata il 21-23 giugno 2022, in occasione della fiera Embedded World, a Norimberga, Germania (Padiglione 1; Stand 1-234).

**Disponibilità**

La famiglia DA1470x consiste in 4 nuovi dispositivi, tutti sono già in produzione e disponibili. Maggiori informazioni sui nuovi dispositivi sono pubblicate alla seguente pagina [renesas.com/DA1470x](https://www.renesas.com/products/interface-connectivity/wireless-communications/bluetooth-low-energy/da14706-highly-integrated-advanced-bluetooth-52-soc?utm_campaign=conn_ble_da1470x&utm_source=press_release&utm_medium=press_release&utm_content=da14706).

**A proposito di Renesas Electronics Corporation**

Renesas Electronics Corporation ([TSE: 6723](http://www.jpx.co.jp/english/)) offre un futuro più sicuro, intelligente e sostenibile in cui la tecnologia aiuta a semplificarci la vita. Renesas, un fornitore leader a livello mondiale, con la capacità di combinare la propria esperienza in ambito di elaborazione integrata, analogica, dispositivi di potenza e connettività, con lo scopo di fornire soluzioni complete a semiconduttore. Queste Winning Combinations, permettono un time-to-market immediato per tutte le applicazioni in ambito automobilistico, industriale, infrastrutturale e IoT, consentendo di realizzare miliardi di dispositivi intelligenti e connessi, che migliorano il modo in cui le persone vivono e lavorano. Scopri di più su [renesas.com](http://www.renesas.com/). Seguici su [LinkedIn](https://www.linkedin.com/company/renesas/), [Facebook](https://www.facebook.com/RenesasElectronics/), [Twitter](https://twitter.com/renesasglobal), [YouTube](https://www.youtube.com/user/RenesasPresents) e [Instagram](https://www.instagram.com/renesas_global/).

###

Arm and Arm Cortex are trademarks or registered trademarks of Arm Limited in the EU and other countries. All names of products or services mentioned in this press release are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

**Contatto per ulteriori informazioni:**

Alexandra Janetzko / Martin Stummer

HBI Helga Bailey GmbH (PR agency), Stefan-George-Ring 2, 81929 Munich, Germany

Tel.: +49 89 99 38 87-32 / -34

Email: [alexandra\_janetzko@hbi.de](mailto:alexandra_janetzko@hbi.de) / [martin\_stummer@hbi.de](mailto:martin_stummer@hbi.de)

Web: [www.hbi.de](http://www.hbi.de/)

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |